

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2022-011

债券代码：124004

债券简称：中京定转

债券代码：124005

债券简称：中京定 02

惠州中京电子科技股份有限公司

关于投资建设珠海集成电路（IC）封装基板产业项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、投资项目概述

根据公司经营计划及中长期战略发展规划，为进一步提升公司技术水平、丰富公司产品组合、增强公司长期核心竞争力，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于投资建设珠海集成电路（IC）封装基板产业项目的议案》，公司拟以自有资金及自筹资金人民币 15 亿元用于珠海集成电路（IC）封装基板产业项目建设。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

公司拟在珠海投资建设集成电路（IC）封装基板产业项目，具体情况如下：

- 1、项目实施主体：珠海中京半导体科技有限公司；
- 2、主要产品：以生产 FC-CSP、WB-CSP 应用产品为主；开展 FC-BGA 应用产品的技术开发；
- 3、投资规模：项目总投资约人民币 15 亿元，其中固定资产投资总额约 13 亿元；
- 4、项目地点：珠海市高栏港经济技术开发区；
- 5、资金来源：自有资金及自筹资金。

三、项目投资目的及对公司的影响

IC 封装基板是集成电路与半导体封装的重要基础材料，广泛应用于智能手机、计算机、网络通信、数据存储、光电显示、消费电子、汽车电子等领域芯片封装。本次投资建设 IC 封装基板产业项目，有利于促进公司产业升级，丰富产品组合，满足公司的战略与发展目标，进一步提升公司的市场竞争力。具体如下：

1、符合国家产业政策，具有良好的社会效益

半导体产业为国家高新技术产业发展重心，IC 封装基板为半导体封测产业的主要材料，是国家产业支持与发展的方向之一。目前国内 IC 封装基板厂商较少，供应不足，投资建设该项目有利于打破由日本、韩国、中国台湾地区等少数厂商垄断的局面，逐步实现国产化替代，提高国内集成电路产业封装基板的自给率。

2、市场前景广阔，具有良好的经济效益

随着数字化与智能化的快速发展，5G 通信、计算机、数据中心、智能驾驶、物联网、人工智能、云计算等领域技术迭代加快，相关半导体与集成电路市场规模迎来高速增长机会；受益于国内信息安全和自主可控增强需求、以及近年来国内半导体产业链高速发展，国内晶圆产能的扩张和半导体封测产业占全球份额的持续增长，对半导体封装材料的国产化配套需求持续提升，IC 封装基板作为核心的半导体封装材料，市场前景广阔。

3、公司已具备 IC 封装基板产业投资基础及可行性

(1) 该项目建设用地已合法取得并获得项目备案、环境评价批文，项目已达到可建设条件；

(2) IC 封装基板与高阶 PCB 在制造工艺和管理经验上有共通之处，公司已储备丰富的精密精细高阶印制电路生产技术与管理经验及人才队伍，有利于公司发展 IC 封装基板业务；

(3) 公司于 2020 年开始启动 IC 封装基板研发立项，已完成 IC 封装基板专业核心团队搭建，已组建 IC 封装基板单体生产线，目前已与多家半导体相关企业开展样品生产与小批量测试验证。

4、符合公司战略发展目标，有利于提升公司核心竞争力

投资建设 IC 封装基板产业项目是公司实现中长期发展目标的重要举措，有利于公司抓住市场发展机遇，促进公司电子信息产业链升级。

本次项目投资有利于公司充分发挥整体资源和优势，发展半导体产业，丰富公司产品组合并积极培育高端产品市场，进一步提升核心竞争力和持续盈利能力。本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险及应对方式

1、因不可抗力或客观原因影响，可能存在不能按照项目建设周期及进度进行施工的风险。公司将合理安排工期，确保该项目建设如期完成。

2、本次投资涉及的投资规模相对较大，对公司的项目管理、资金管理能力的要求较高，存在一定的项目资金安排及管理风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、IC 封装基板的生产经营将受宏观经济波动、国家政策、行业发展变化、经营管理等因素影响，可能存在行业景气度下滑、市场需求萎缩，公司订单数量达不到预期水平，不能消化新增产能及实现预期收益的风险。公司将充分关注宏观环境、行业和市场的变化，不断适应新的发展要求，并通过提升内部管理水平、积极开拓市场、不断提高产品市场差异化与竞争能力等方式应对市场风险。

4、IC 封装基板所需原材料、部分设备目前依赖于进口，如国际政治经济环境变化，可能存在部分原材料与部分设备的供应风险。公司将与主要原材料供应商建立长期合作机制，并积极与国内厂商合作促进 IC 封装基板核心原材料的国产化进程，以保障原材料长期供应；公司与相关主要设备供应商保持了良好的长期稳定合作关系，并将提前规划相关核心进口设备采购，以保障设备交付。

5、IC 封装基板具有较高的技术壁垒，专业人才培养周期较长，可能存在短期技术人员不足，无法匹配行业及公司发展需求的风险。公司将积极引入半导体领域技术专家，持续完善多维度的激励体系，提高员工积极性和忠诚度；持续增加产品研发投入力度，加快工艺制程技术开发，不断提升公司技术研发能力；并继续就该项目开展人才储备工作，打造后备梯队人才资源池，提升自主培养人才的综合能力，为未来发展提供支持。

五、其他

本次投资实施进度及资金安排将根据项目实施的具体情况确定，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。

公司将根据本次投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续相关公告。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022年2月28日